



# 产品加工指南

半固化片:Synamic 6B(F)

超低损耗多层板用粘结材料



本产品使用指南依托于 IPC-4101E 标准，并在该标准的基础上，根据产品特征的实际情况进行整理，使之更利于生益 Synamic 6B(F)产品的使用。

## 1. 储存条件

### 1.1 存放方式

- 以原包装形式水平存放，避免重压，防止存放方式不妥而引起的半固化片破损；
- 裁剪后剩余的卷状半固化片仍需用保鲜膜密封包装好，放回原包装中托架上。

### 1.2 存放环境

- 半固化片应密封包装存放在无紫外光照射的环境下，具体存放条件及储存期如下：
  - 条件一：温度 $<23^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $<50\%$ ，储存期为 3 个月；
  - 条件二：温度 $<5^{\circ}\text{C}$ ，储存期为 6 个月；
- 相对湿度对于半固化片品质影响最大，需加以关注（天气潮湿时要作相应的除湿处理）。

### 1.3 剪裁操作

- 剪裁由专业人员戴上清洁的手套操作，防止半固化片表面被污染；操作要小心，防止半固化片起皱或折痕。

### 1.4 使用注意事项

- 半固化片从冷库取出，在打开包装之前必须经过回温过程，回温时间为 8-24 小时（视乎具体存放条件），待和环境温度相同后打开包装；
- 已经开成片状的半固化片需存放在条件一或条件二环境下，并尽快用完，超过 3 天，必须复检其指标合格后再使用；
- 卷状半固化片打开包装后，对于剩余的卷状尾数部分，要求进行原包装程度的密封包装，并存放在条件一或条件二中；

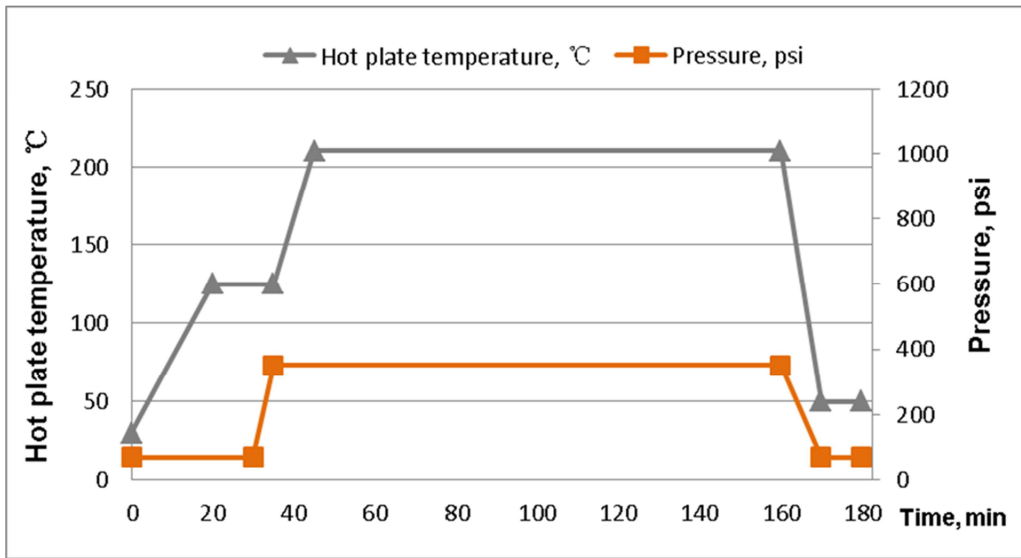
## 2. PCB 加工建议

### 2.1 叠料

- 叠料过程避免反转或者翻转的动作，以减少由此引起的折皱问题。

### 2.2 层压

- 使用真空压机；
- 层压时升温速率为：材料温度在  $100\sim 180^{\circ}\text{C}$  的区域内， $2.0\sim 5.0^{\circ}\text{C}/\text{min}$ （建议  $3.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ）；
- 层压时压力设置：在材料温度为  $130^{\circ}\text{C}$  时转高压  $350\sim 450\text{ psi}$ （建议  $450\text{ psi}$ ）；
- 固化条件：固化温度  $200\sim 205^{\circ}\text{C}$ ，固化时间  $> 90\text{min}$ ；



### 2.3 钻孔

- 机械钻孔：为保证良好的孔壁质量，建议采用新钻刀，孔限控制在 300~1000 孔（建议 500 孔），在普通 FR-4 钻孔参数的基础上，建议适当地提高 Chipload，有利于改善晕圈（白纹）。建议参数如表 1：

表 1：机械钻孔参数表（建议）

刀径		落速	转速	回刀速	孔限	Chipload
mm	inch	ipm	krpm	ipm	/	mil/rev
0.20	0.0078	67	95	500	500	0.71
0.25	0.0097	71	95	500	500	0.75
0.30	0.0117	76	95	500	500	0.80
0.35	0.0136	81	95	500	500	0.85
0.40	0.0156	105	63	500	500	1.67
0.45	0.0175	110	60	500	500	1.83
0.50	0.0195	125	62	1000	500	2.02
0.55	0.0214	127	60	1000	500	2.12
0.60	0.0233	130	58	1000	500	2.24
0.65	0.0253	125	55	1000	500	2.27
0.70	0.0272	125	53	1000	500	2.36
0.75	0.0292	125	51	1000	500	2.45
0.80	0.0311	125	50	1000	500	2.50
0.85	0.0331	124	49	1000	500	2.53
0.90	0.0350	123	48	1000	500	2.56
0.95	0.0370	122	47	1000	500	2.60
1.00	0.0389	121	46	1000	500	2.63
1.05	0.0409	121	45	1000	500	2.69
1.10	0.0428	120	44	1000	500	2.73
1.30	0.0506	120	35	1000	500	3.43
1.50	0.0584	115	32	1000	500	3.59
1.70	0.0661	100	28	1000	500	3.57
1.90	0.0739	90	23	1000	500	3.91



备注：实际使用的机械钻孔参数需依据刀径、层数、板厚度、叠板数和叠板高度等进行调整。

- 激光钻孔：可进行激光钻孔加工，需依据不同应用场景进行参数调整

## 2.4 钻孔后烘板

- 建议钻孔后烘板条件：190°C/4 ~ 6h，注意板材不能与热源直接接触。

## 2.5 去钻污

- 由于 Synamic 6B(F)材料去钻污的咬噬速率小于目前大多数的无铅 FR-4 材料，为保证去钻污效果建议采用以下方式：

首先采用等离子体方式去钻污（等离子体建议的参数如表 2），然后再采用一次常规化学除胶方式去钻污；  
优先采用一次等离子体加一次化学除胶的方式去钻污，整体咬噬量建议控制在 0.2 ~ 0.4mg/cm<sup>2</sup>；

表 2：等离子体去钻污参数（建议）

Parameter	Gas Flow Rate ( L/min )			Mode	Watts ( V )	Time (min)	Temp. ( °C )	Flow Rate (SLM)	Pressure ( mTorr )	Plasma Mode
	O2	N2	CF4							
Seg 1	2.25	0.25	0.00	V	9000	45.0	80.0	2.50	250	Conductance
Seg 2	2.46	0.24	0.30	P	6500	20.0	105.0	3.00	220	Conductance
Seg 3	2.50	0.00	0.00	P	5000	5.0	100.0	2.50	250	Conductance

## 2.6 外形加工

- 建议采用铣床进行加工，适当降低铣刀速以避免板边分层问题，不建议采用啤板方式进行加工。

## 2.7 包装

- 建议在包装前进行烘板，烘板条件 125°C/4~6h，以避免潮气造成耐热性下降问题；
- 包装材料建议采用铝箔真空包装。

## 3. 焊接工艺

### 3.1 包装有效期

- 推荐 3 个月内；元件组装前最好 150°C/4~6h 或 170°C/2~4h 烘烤后再使用；

### 3.2 回流焊接参数

- 适合于常规无铅回流焊接加工工艺。

在使用生益 Synamic 6B(F)产品期间，如有任何疑问及建议，请随时联系生益，生益将给您提供快捷有效的技术服务。